

삼성전기 박사채용 공고

글로벌 초일류 전자부품기업으로 도약하고 있는 삼성전기에서 새로운 변화와 도전을 꿈꾸는 인재를 모십니다.

회사소개

IT기술은 우리의 생활양식과 사회구조는 물론, 산업 환경에 엄청난 변화를 가져오고 있습니다. 산업의 부가가치는 완성품에서 부품, 소재산업이나 서비스 및 Contents 산업으로 이동하고 있고, 사업의 Paradigm은 개별 제품 중심에서 여러 제품이 복합화 된 Convergence 제품으로 변화하고 있습니다. 이러한 변화 속에서 삼성전기는 1973년 창립 이래 전자제품의 성능을 좌우하는 핵심부품을 개발하며 첨단 기술을 선도하고 있습니다. 도전과 열정 그리고 탁월한 전문성으로 디지털 세상의 변화와 혁신을 이끌우수한 인재의 많은 지원을 기다립니다.

※ 상세 내용은 홈페이지 참조: www.samsungsem.com

모집분야 및 지원자격

모집 직무	수행 업무	지원자격
영상처리	□ 영상 신호 처리 및 컴퓨터 비전 알고리즘 개발 □ 패턴 인식 알고리즘 및 Software 개발 □ Embedded 기반 Porting & Integration - C, C++, Java 활용 O/S Platform 설계	컴퓨터/제어 전공
PA 및 PA Module	□ PA(Power Amplifier) 및 PA Module 개발 - PA 설계 및 분석, 특성 평가, Trouble-shooting (ADS, HFSS, CST, Zuken 등 활용) □ 복합 FEM(Front end Module) 회로 설계 - PA, Switch, Filter/Duplexer, Controller 기반 □ EM 시뮬레이션 및 Set 매칭 검토	전기전자 전공

재료 개발	□ 고분자재료 - 고밀도 기판용 광 또는 열경화성 절연재료 □ 유전체재료 □ 금속/고분자 복합재료 - 세라믹, 방열 Filler/Epoxy 재료 - 자성체/고분자 재료	
공정 개발	 □ 도금 - 기판 및 수동소자의 미세패턴 형성을 위한 도금 공법 개발 - 전기적 특성 평가 - 박막(진공증착) 개발 □ 노광/에칭 - 금속 및 금속/고분자 복합재료의 Litho, Etching 공법 및 Etching Etchant 개발 □ PKG 공정 - PKG Interconnection (Bump, Wire, SMT 등) 	화학/화공/재료/고분자 전공

지원방법

- 지원방법 : 인사담당자 E-Mail 로 이력서 접수(제목: 관심분야/학교/이름 포함)

- 전형절차 : 서류심사→전문성면접(Phone)→임원면접→건강검진→최종합격

이력서 접수/문의

- 접수 : 인사팀 박상원 사원 (sangwon0903.park@samsung.com)
- 각종 증빙서류는 추후 안내되며 허위사실이 있을 경우 채용이 취소될 수 있습니다.
- 첨부의 개인정보수집 동의서 파일을 열어 내용을 확인하신 후 상단 성명과, 하단 동의일, 성명/서명, 동의여부 체크를 입력하여 이력서와 함께 첨부해주시기 바랍니다.